

证券简称：晶合集成

证券代码：688249

合肥晶合集成电路股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-005

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	泰康基金、中邮电子、华福证券、宝盈基金、泉果基金。
会议时间	2024年6月12日
会议地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	朱才伟 董事、董事会秘书、财务负责人、副总经理 黄凯全 企业规划室部经理 曹宗野 证券事务代表
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题 1、公司目前的产能建置情况如何，后续是否有扩产计划？ 答复：公司目前的产能是 12 万片/月，后续将根据市场需求情况弹性安排产能扩充节奏。</p> <p>问题 2、请问公司 5000 万像素 BSI 的进展？ 答复：公司 55nm 的单芯片、高像素背照式图像传感器（BSI）已经进入量产阶段。</p> <p>问题 3、公司当前研发人员能否满足公司未来战略规划？ 答复：2023 年底公司研发人员占公司员工总人数 36%左右，较 2022 年底有所提升。未来公司将持续进行研发团队的建设与研发能力的提升，不断丰富公司产品结构，为客户提供丰富的产品解决方案。</p> <p>问题 4、请问公司回购股份的用途是什么？进展如何？ 答复：公司本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。截至目前，上述股份回购事项仍在进行中，后续进展敬请关注公司披露的相关公告。</p>

	问题 5、请问公司 OLED 最新的研发进展如何？ 答复：40nm 高压 OLED 已成功点亮面板，28nm 产品开发正在稳步推进中。
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 6 月 14 日